

ID	IPC	类名
1	G06F	电数字数据处理（基于特定计算模型的计算机系统入G06N）
2	G06K	数据识别；数据表示；记录载体；记录载体的处理（印刷本身入B41J）
3	H05K	印刷电路；电设备的外壳或结构零部件；电气元件组件的制造（其他类目不包括的仪器零部件或其他设备的类似零部件入G12B；薄膜或厚膜电路入H01L 27/01，H01L 27/13；用于对印刷电路或印刷电路之间的电连接的非印刷方法入H01R；用于特殊类型设备的外壳或其结构零部件，见有关小类；仅包括单一工艺的加工方法，例如已列入其他类目的加热、喷射，见有关的类）
4	G06Q	专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法；其他类目不包含的专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的处理系统或方法〔8〕
5	H04N	图像通信，如电视
6	H04L	数字信息的传输，例如电报通信（电报和电话通信的公用设备入H04M）〔4〕
7	G06T	一般的图像数据处理或产生〔6，2006.01〕
8	H01L	半导体器件；其他类目中不包括的电固体器件（使用半导体器件的测量入G01；一般电阻器入H01C；磁体、电感器、变压器入H01F；一般电容器入H01G；电解型器件入H01G 9/00；电池组、蓄电池入H01M；波导管、谐振器或波导型线路入H01P；线路连接器、汇流器入H01R；受激发射器件入H01S；机电谐振器入H03H；扬声器、送话器、留声机拾音器或类似的声机电传感器入H04R；一般电光源入H05B；印刷电路、混合电路、电设备的外壳或结构零部件、电气元件的组件的制造入H05K；在具有特殊应用的电路中半导体器
9	H01R	导电连接；一组相互绝缘的电连接元件的结构组合；连接装置；集电器（开关，熔断器入H01H；波导型耦合装置入H01P 5/00；供电或配电切换装置入H02B；电线或电缆、光电电线或电缆或电气辅助设备的安装入H02G；与印刷电路电连接或印刷电路之间电连接用的印制装置入H05K）
10	G01C	测量距离、水准或者方位；勘测；导航；陀螺仪；摄影测量学或视频测量学（液体水平面的测量入G01F；无线电导航，通过利用无线电波的传播效应，例如多普勒效应，传播时间来测定距离或速度，利用其他波的类似装置入G01S）
11	G06N	基于特定计算模型的计算机系统〔7〕
12	G01S	无线电定向；无线电导航；采用无线电波测距或测速；采用无线电波的反射或再辐射的定位或存在检测；采用其他波的类似装置
13	H04W	无线通信网络〔2009.01〕
14	H04B	传输〔4〕

15	H04M	电话通信（通过电话电缆控制其他设备，但不包括电话交换设备的电路入G08）
16	A61L	材料或消毒的一般方法或装置；空气的灭菌、消毒或除臭；绷带、敷料、吸收垫或外科用品的化学方面；绷带、敷料、吸收垫或外科用品的材料（以所用药剂为特征的机体保存与灭菌入A01N；食物或食品的保存，如灭菌入A23；医药、牙科或梳妆用的配制品入A61K）〔4〕
17	B01D	分离（用湿法从固体中分离固体入B03B、B03D，用风力跳汰机或摇床入B03B，用其他干法入B07；固体物料从固体物料或流体中的磁或静电分离，利用高压电场的分离入B03C；离心机、涡旋装置入B04B；涡旋装置入B04C；用于从含液物料中挤出液体的压力机本身入B30B 9/02）〔5〕
18	B01F	混合，例如，溶解、乳化、分散（混合颜料入B44D 3/06）
19	B01J	化学或物理方法，例如，催化作用或胶体化学；其有关设备〔2〕
20	B22F	金属粉末的加工；由金属粉末制造制品；金属粉末的制造（用粉末冶金法制造合金入C22C；）；金属粉末的专用装置或设备
21	B29C	塑料的成型或连接；塑性状态材料的成型，不包含在其他类目中的；已成型产品的后处理，例如修整（制作预型件入B29B 11/00；通过将原本不相连的层结合成为各层连在一起的产品来制造层状产品入B32B 7/00至B32B 41/00）〔4〕
22	C01B	非金属元素；其化合物（制备元素或二氧化碳以外无机化合物的发酵或用酶工艺入C12P 3/00；用电解法或电泳法生产非金属元素或无机化合物入C25B）
23	C04B	石灰；氧化镁；矿渣；水泥；其组合物，例如：砂浆、混凝土或类似的建筑材料；人造石；陶瓷（微晶玻璃陶瓷入C03C 10/00）；耐火材料（难熔金属的合金入C22C）；天然石的处理〔4〕
24	C07C	无环或碳环化合物（高分子化合物入C08；有机化合物的电解或电泳生产入C25B 3/00，C25B 7/00）
25	C08F	仅用碳-碳不饱和键反应得到的高分子化合物（由低碳烃制造液态烃混合物，例如通过齐聚作用入C10G 50/00；发酵或使用酶的方法合成目标化合物或组合物或从外消旋混合物中分离旋光异构体入C12P；含有碳-碳不饱和键的单体接枝聚合到纤维、丝线、纱线、织物或用这些材料制成的纤维制品入D06M 14/00）〔2〕
26	C08G	用碳-碳不饱和键以外的反应得到的高分子化合物（发酵或使用酶的方法合成目标化合物或组合物或从外消旋混合物中分离旋光异构体入C12P）〔2〕

27	C08J	加工；配料的一般工艺过程；不包括在C08B，C08C，C08F，C08G或C08H小类中的后处理（塑料的加工，如成型入B29）〔2〕
28	C08K	使用无机物或非高分子有机物作为配料（涂料、油墨、清漆、染料、抛光剂、黏合剂入C09）〔2〕
29	C09B	有机染料或用于制造染料的有关化合物；媒染剂；色淀（发酵或用酶的方法合成的目标化合物入C12P）
30	C09K	不包含在其他类目中的各种应用材料；不包含在其他类目中的材料的各种应用
31	C22B	金属的生产或精炼（金属粉末或其悬浮物的制取入B22F 9/00；电解法或电泳法生产金属入C25）；原材料的预处理
32	C23C	对金属材料的镀覆；用金属材料对材料的镀覆；表面扩散法，化学转化或置换法的金属材料表面处理；真空蒸发法、溅射法、离子注入法或化学气相沉积法的一般镀覆（挤压法制造包覆金属的产品入B21C23/22；通过将预先存在的薄层连接到制品上的方法用金属进行镀覆处理的见各有关位置，例如B21D39/00，B23K；玻璃的金属化入C03C；砂浆、混凝土、人造石、陶瓷或天然石的金属化入C04B41/00；金属的搪瓷或向金属上镀覆玻璃体层入C23D；用电解法或电泳法处理金属表面或镀覆金属入C25D；单晶膜生长入C30B；纺织品
33	D01F	制作人造长丝、线、纤维、鬃或带子的化学特征；专用于生产碳纤维的设备〔2〕
34	D03D	机织织物；织造方法；织机
35	E04B	一般建筑物构造；墙，例如，间壁墙；屋顶；楼板；顶棚；建筑物的隔绝或其他防护（墙、楼板、或顶棚上的开口的边沿构造入E06B 1/00）
36	E04C	结构构件；建筑材料（桥梁用的入E01D；专门设计作隔绝或其他防护用途的入E04B；辅助建筑构件入E04G；采矿用的入E21；隧道用的入E21D；具有除建筑工程以外更广泛用途的结构构件入F16，特别是F16S）
37	F24F	空气调节；空气增湿；通风；空气流作为屏蔽的应用（从尘、烟产生区消除尘、烟入B08B 15/00；从建筑物中排除废气的竖向管道入E04F17/02；，烟道末端入F23L17/02）
38	F25B	制冷机，制冷设备或系统；加热和制冷的联合系统；热泵系统（热传导、热交换或热贮存材料，即制冷剂，或通过化学反应而不是燃烧产生热或冷的材料入C09K 5/00；泵、压缩机入F04；用热泵为住宅或场所供热或提供家用热水入F24D；空调，空气增湿入F24F；采用热泵的流体加热器入F24H）

39	G01N	借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料（除免疫测定法以外包括酶或微生物的测量或试验入C12M, C12Q)
40	G02F	用于控制光的强度、颜色、相位、偏振或方向的器件或装置，例如转换、选通、调制或解调，上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的；用于上述操作的技术或工艺；变频；非线性光学；光学逻辑元件；光学模拟/数字转换器 [2, 4]
41	H01B	电缆；导体；绝缘体；导电、绝缘或介电材料的选择（磁性材料的选择入H01F 1/00；波导管入H01P)
42	H01L	半导体器件；其他类目中不包括的电固体器件（使用半导体器件的测量入G01；一般电阻器入H01C；磁体、电感器、变压器入H01F；一般电容器入H01G；电解型器件入H01G 9/00；电池组、蓄电池入H01M；波导管、谐振器或波导型线路入H01P；线路连接器、汇流器入H01R；受激发射器件入H01S；机电谐振器入H03H；扬声器、送话器、留声机拾音器或类似的声机电传感器入H04R；一般电光源入H05B；印刷电路、混合电路、电设备的外壳或结构零部件、电气元件的组件的制造入H05K；在具有特殊应用的电路中半导体器
43	H01M	用于直接转变化学能为电能的方法或装置，例如电池组 [2]（一般电化学的方法或装置入C25；用于转变光或热为电能的半导体或其他固态器件入H01L，例如H01L 31/00, H01L 35/00, H01L 37/00) [2]
44	14类	记录、通信、信息检索设备
45	05-06	人造或天然材料片材
46	10-05	检测、安全和测试用仪器、设备和装置
47	11-01	珠宝和首饰
48	24-01	医生、医院和实验室用的仪器和设备
49	24-02	医疗器械、实验室用器械和实验室用工具
50	25-01	建筑材料
51	10-02	表和手表
52	12-07	航空器和太空运载工具